

Print-Schablone BGA 225 für Dip- und Print-Station - Ersä OPR100-S001

Artikel-Nr.	ER-OPR100-S001	Hersteller	Ersä
Hersteller-Nr.	OPR100-S001	EAN	4003008090857

Print-Schablone in der Ausführung BGA 225 für die Ersä Dip- und Print-Station OPR100. Sie überträgt Lotpaste präzise und reproduzierbar auf die Anschlüsse von BGA- und SMD-Bauteilen und dient der Bauteilvorbereitung beim Rework.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
ESD-Ausrüstung	ESD Lötstationen
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Ersä Print-Schablone BGA 225 ist ein bauteilspezifisches Zubehör für die Ersä Dip- und Print-Station OPR100. Das Bauteil wird in die Schablone eingespannt, von unten mit Lotpaste bedruckt, anschließend entnommen und mit der Bestückerinheit platziert. So lassen sich die Anschlüsse von BGA- und SMD-Bauteilen einfach, präzise und reproduzierbar mit Lotpaste versehen.

Technische Daten

Merkmal	Wert
Typ	Print-Schablone
Ausführung	BGA 225
Kompatibles System	Ersä Dip- und Print-Station OPR100
Hersteller-Artikelnummer	OPR100-S001
EAN	4003008090857